

Gorąca płyta do pracy z komponentami SMD/BGA (reballing BGA)

Model : SMD-928S



Najlepszy wybór do reballing'u BGA

Szybka i niezawodna gorąca płyta

- Urządzenie umożliwia szybką wymianę kulek komponentu BGA - proces może trwać zaledwie 3 minuty
- Doskonała skuteczność cieplna dla układu BGA przed wymianą kulek
- Wbudowane zaawansowane elementy grzejne typu radiacyjnego
- Optymalny do podgrzewania płyt głównych PC, produkcji małoseryjnej oraz podtrzymania temperatury na PCB

PID - System Precyzyjnej Kontroli Temperatury

- Stabilizacja temperatury $\pm 1^{\circ}\text{C}$
- Dwuliniowy precyzyjny wyświetlacz:
 - Wyświetlacz temperatury zadanej przez operatora
 - Wyświetlacz temperatury rzeczywistej - odczytywanej za wbudowanej termopary typu K
- Czas trwania procesu regulowany potencjometrem
- Pokrywa zapewniająca ochronę operatora

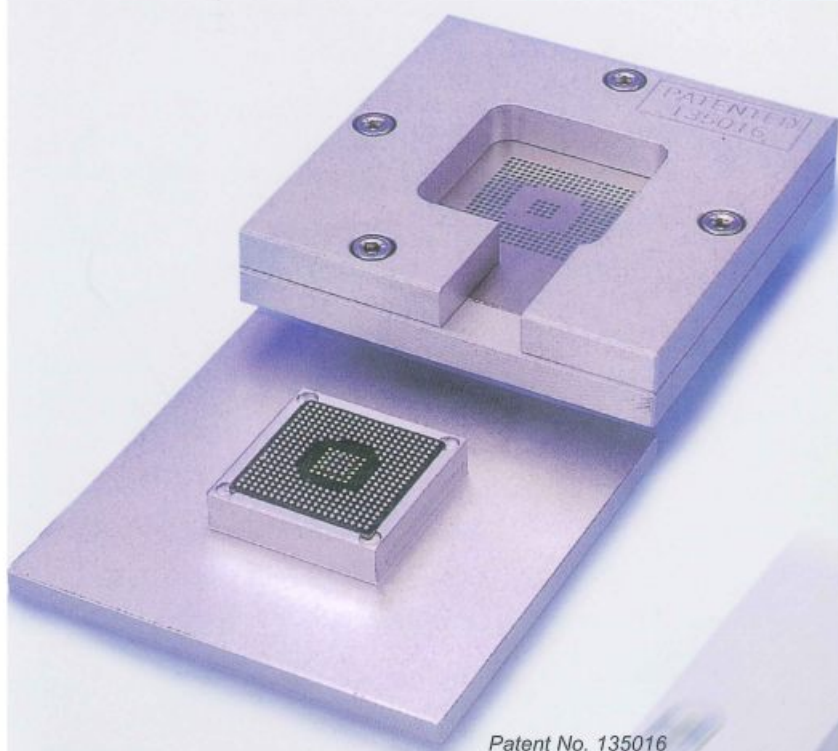
DANE TECHNICZNE

Zasilanie:	115VAC/230VAC
Maksymalna moc:	1000 W max
Zakres temperatur:	0-400°C
Stabilizacja temperatury:	+/-1°C od temperatury ustawienia
Wymiary płyty:	150 x 200 x 13 mm
Wymiary urządzenia:	280 x 240 x 170 mm
Czas nagrzania do 200°C:	6 minut
Termopara:	typu K
Masa:	około 7,5 kg

Akcesoria i materiały do reballing'u

Szablony do reballing'u BGA

- Szybki i wygodny montaż komponentu BGA
- Możliwość pracy z komponentami typu BGA, μ BGA, CSP i LLP
- Konstrukcja wykonana z wysokiej jakości stopu aluminium
- Jeden cykl pracy z BGA może trwać od 30 do 90 sekund



Patent No. 135016

Topnik w żelu

- Topnik do aplikacji na szablon przed lutowaniem kulek na komponentie BGA
- Z powodzeniem może być używany w procesie podgrzewania promieniami podczerwieni (IR)
- Nie wymaga czyszczenia po lutowaniu (No-Clean)



Kulki lutownicze do komponentów BGA

- Tolerancja średnicy: 0,02 mm.
- Pakowane w atmosferze ochronnej (argon)
- Szeroka oferta rozmiarów: 0,2, 0,3, 0,45, 0,5, 0,6 i 0,76 mm (średnica)
- Kulki bezołowiowe

